

产品简介

YDIV27-08122C1 是一款高性能 GaAs MMIC 功分器芯片，工作频率 8 到 12 GHz。该芯片具有 0.45dB 的插入损耗，隔离度大于 21dB。

关键技术指标

- 工作频段: 8 ~ 12 GHz
- 隔离度: 21dB
- 插入损耗: 0.45 dB
- 芯片尺寸: 0.90mm x 0.95mm

应用领域

- 通信
- 仪器仪表



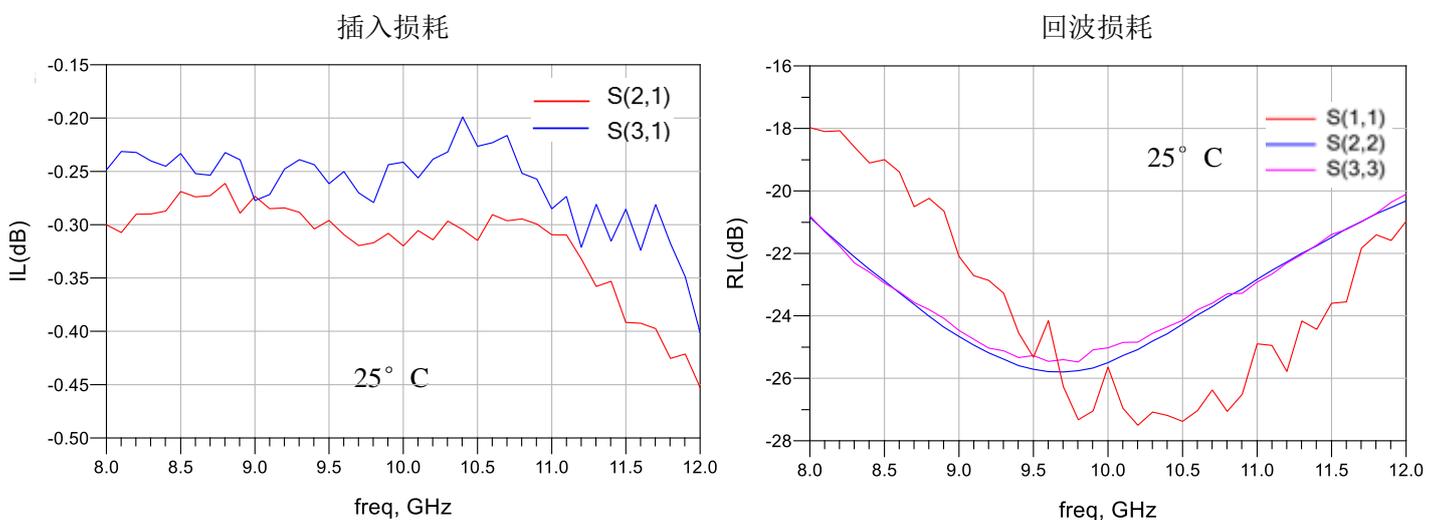
电性能表 (TA=+25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	8 – 12			GHz
输入驻波	-	19	-	dB
输出驻波	-	20	-	dB
插入损耗	-	0.45	-	dB
隔离度	-	21	-	dB

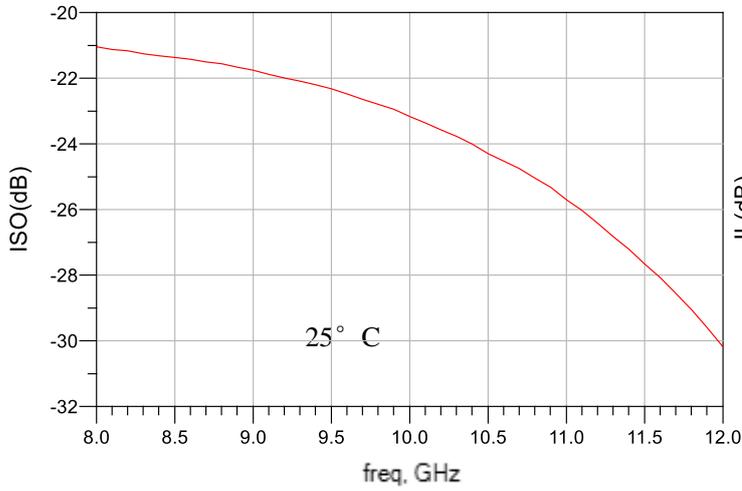
绝对额定最大值

参数	符号	数值
最大输入功率	Pin	37dBm
存储温度	T _{STG}	-65°C~150°C
使用温度	T	-55°C~85°C

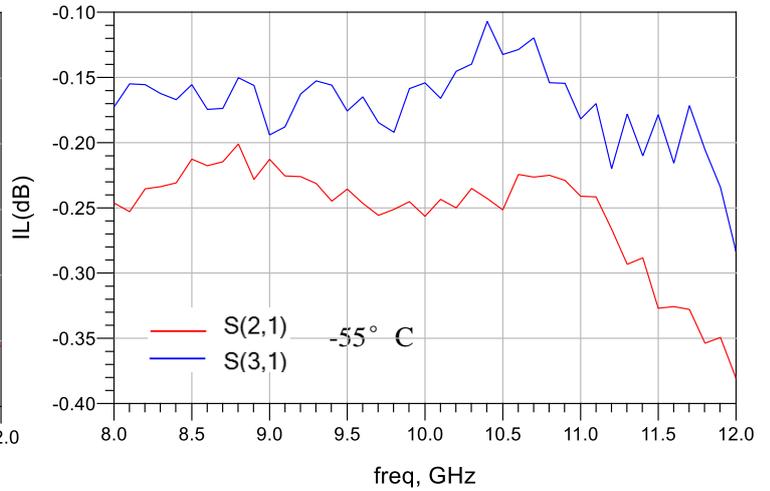
典型测试曲线



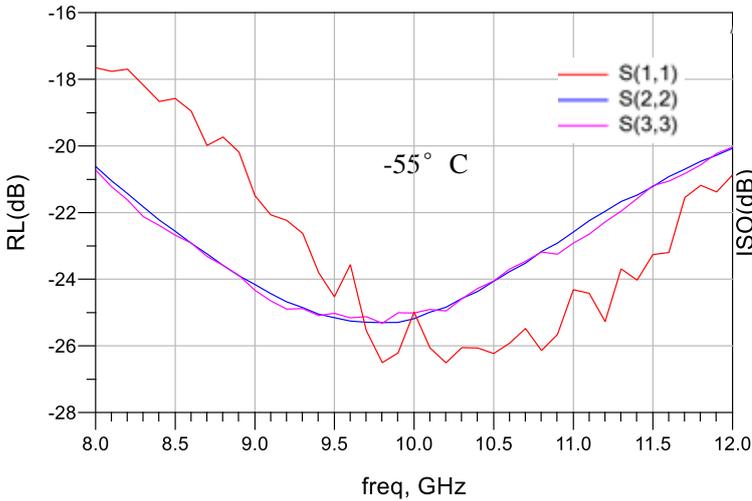
隔离度



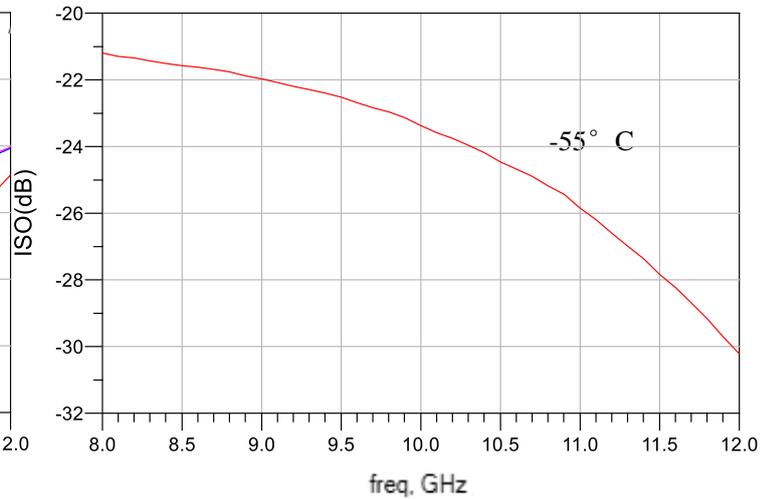
插入损耗



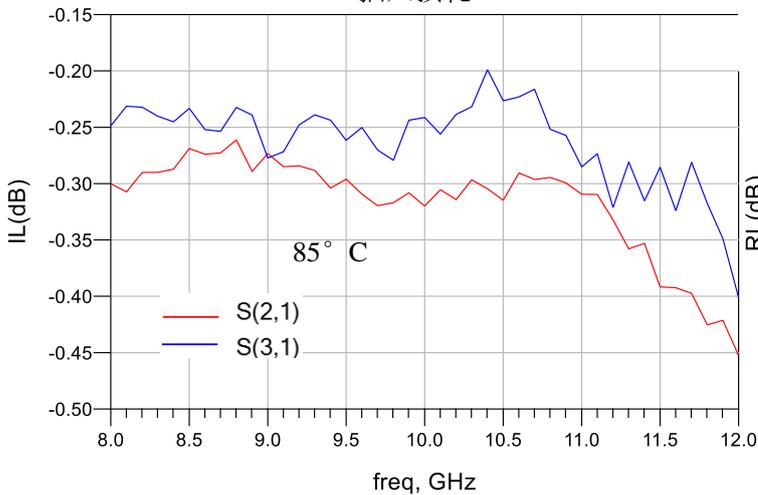
回波损耗



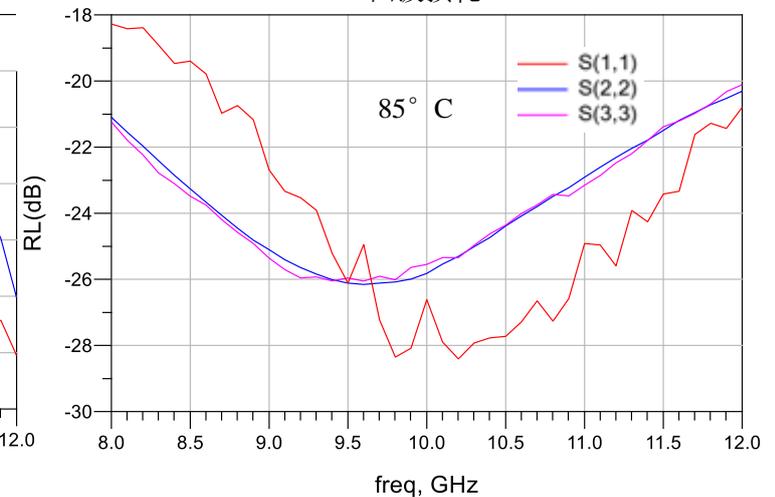
隔离度

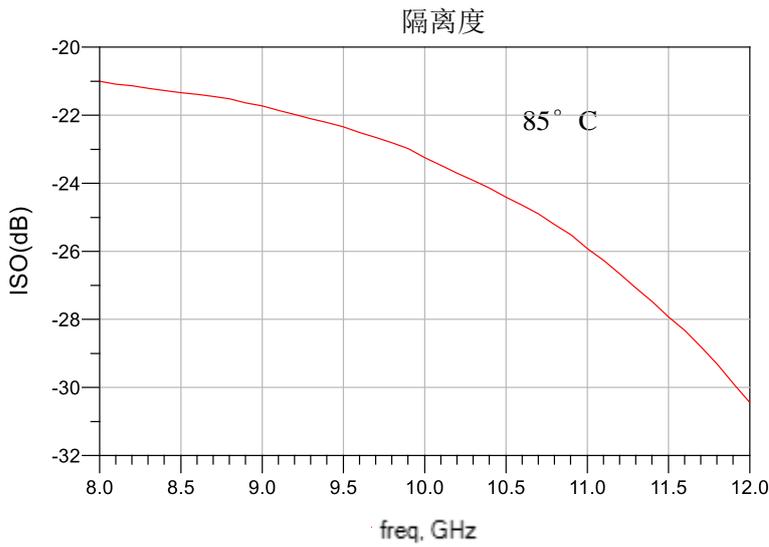


插入损耗

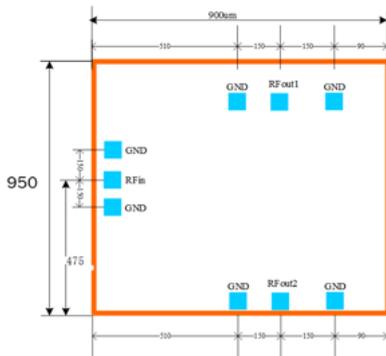


回波损耗

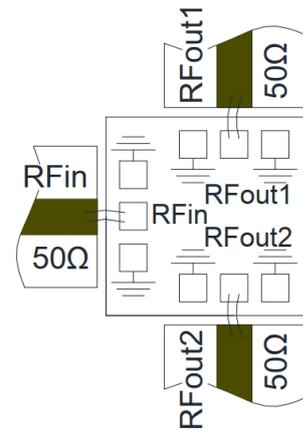




外形和端口尺寸 (μm)



推荐装配图



端口定义

端口名	定义	信号或电压
RFIN1	射频输入	RF
RFOUT1/2	射频输出	RF

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境中使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。